

HOCHSCHULE LUZERN  
TECHNIK UND ARCHITEKTUR

BACHELOR THESIS

# Entwicklung einer PCB zur Analyse von Umgebungslärm

*Stefano Nicora*

7. Juni 2024

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
1.1	Ausgangslage . . . . .	3
1.2	Ziele . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Mikrofon</b>	<b>4</b>
2.1	Grundlagen . . . . .	4
2.1.1	MEMS . . . . .	4
2.1.2	I2S . . . . .	4
2.1.3	PDM . . . . .	5
2.1.4	PCM . . . . .	6
2.1.5	Schalldruckpegel . . . . .	7
2.1.6	Frequenzbewertung . . . . .	8
2.2	Komponentenwahl . . . . .	10
2.2.1	Kriterien . . . . .	10
2.2.2	Vergleich . . . . .	11
2.2.3	Fazit . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Mikrocontroller</b>	<b>12</b>
3.1	Grundlagen . . . . .	12
3.1.1	DMA . . . . .	12
3.1.2	Bootloader . . . . .	12
3.1.3	RTC . . . . .	13
3.1.4	Low Power . . . . .	13
3.1.5	Peripherie in Hardware oder Software . . . . .	13
3.2	Komponentenwahl . . . . .	14
3.2.1	Kriterien . . . . .	14
3.2.2	Vergleich . . . . .	15
3.2.3	Fazit . . . . .	15
<b>4</b>	<b>LED</b>	<b>16</b>
4.1	Grundlagen . . . . .	16
4.1.1	Wellenlänge . . . . .	16
4.1.2	Leistungsaufnahme . . . . .	16
4.1.3	Lichtleistung . . . . .	16
4.1.4	Vorwiderstand / Strombegrenzung . . . . .	16
4.2	Komponentenwahl . . . . .	16

4.2.1	Kriterien . . . . .	16
4.2.2	Vergleich . . . . .	17
4.2.3	Fazit . . . . .	17
<b>5</b>	<b>Entwicklung</b>	<b>18</b>
5.1	Konzept . . . . .	18
5.2	Hardware . . . . .	20
5.2.1	PCB . . . . .	20
5.2.2	Kosten . . . . .	20
5.3	Software . . . . .	21
5.3.1	Filterdesign . . . . .	21
5.3.2	PDM . . . . .	21
5.3.3	I <sup>2</sup> C . . . . .	21
5.3.4	SPI . . . . .	21
<b>6</b>	<b>Messungen</b>	<b>22</b>
6.1	Leistungsaufnahme . . . . .	22
6.2	Mikrofon-Kalibrierung . . . . .	22
6.3	Vergleich . . . . .	22
<b>7</b>	<b>Fazit und Ausblick</b>	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>Anhang</b>	<b>24</b>
8.1	Fremdwörter . . . . .	24

# 1 Einleitung

## 1.1 Ausgangslage

Die Firma hEar hat es sich zum Ziel gesetzt, gegen **TODO**. Dazu wurde in der Masterarbeit von Sophie Mia Willener eine Marktanalyse durchgeführt, sowie ein erster Prototyp gebaut. Dieser Prototyp ist jedoch noch unhandlich und nicht für den Massenmarkt geeignet.

## 1.2 Ziele

Das Ziel dieser Arbeit ist es, in einem ersten Schritt, auf Basis des vorhandenen Prototypen, ein funktionales, kompaktes und portables Schalldruckpegel-Messgerät zu entwickeln. Dabei sollen folgende Rahmenbedingungen zwingend eingehalten werden:

- Die Laufzeit des Gerätes soll mindestens 12 Stunden betragen.
- Das Gerät wird mit einem Akku betrieben. Dieser wird via eines USB-C-Anschlusses aufgeladen.
- Der Schalldruckpegel wird mit einem MEMS-Mikrofon aufgezeichnet.
- Die Messdaten werden in regelmässigen Abständen auf dem Gerät gespeichert.
- Das Gerät verfügt über eine BLE-Schnittstelle um die Messdaten drahtlos an ein Zielgerät zu übertragen.
- Der aktuelle Schalldruckpegel wird auf der Vorderseite des Gerätes visuell dargestellt.

In einem zweiten Schritt, wird das Gerät kalibriert und dessen Qualität mit auf dem Markt bereits vorhandenen Geräten verglichen.

## 2 Mikrofon

### 2.1 Grundlagen

#### 2.1.1 MEMS

#### 2.1.2 I2S

Inter-Integrated Sound (I<sup>2</sup>S) bezeichnet eine Bus-Schnittstelle, welche von Philips zur Übertragung von digitalen Audiosignalen entwickelt wurde. Ähnlich wie I<sup>2</sup>C (Inter-Integrated Circuit) wird die Schnittstelle jedoch nur innerhalb des Gerätes verwendet. Dabei werden drei Pins zwischen Sender (hier das Mikrofon) und dem Empfänger (hier der Mikrocontroller) benötigt:

- **SCK** (Serial Clock)  
Generiert die Taktrate, welche gleichzeitig die Datenrate der Übertragung definiert. Die Taktrate wird vom Master (hier der Mikrocontroller) vorgegeben.
- **WS** (Word Select)  
Gibt vor, welcher Audiokanal (R, L) übertragen werden soll. Dies ermöglicht es, entweder ein Stereo-Signal oder zwei Mono-Signale wie zum Beispiel zwei Mikrofone zu übertragen.
- **SD** (Serial Data)  
Beinhaltet den eigentlichen Datenstream mit der Datenrate definiert durch **SCK** und der Länge definiert durch **WS**.

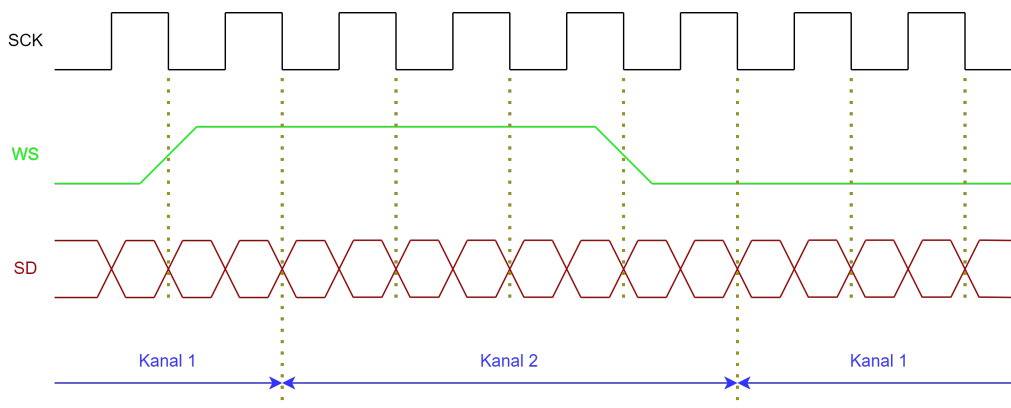


Figure 1: Übersicht I2S-Signale

### 2.1.3 PDM

**P**ulse **D**ensity **M**odulation oder Pulsdichtemodulation bezeichnet die Darstellung eines analogen Signals in der digitalen Ebene. Dabei entspricht das Verhältnis zwischen der Anzahl der digitalen "1" und digitalen "0" der Amplitude des analogen Signales. Das PDM-Signal weist eine vielfach schnellere Taktrate (meist Faktor 32 / 64), als das ursprünglich abgetastete Mikrofonsignal auf. Dadurch wird auftretendes Rauschen in einen höher gelegenen Frequenzbereich verschoben, welcher bei der anschliessenden Signalverarbeitung mit einem Tiefpassfilter abgeschnitten wird. Im Gegensatz zu I<sup>2</sup>S (2.1.2) werden lediglich zwei Pins zwischen Mikrofon und Empfänger benötigt:

- **DAT** (Data)  
Beinhaltet den als PDM-Codierten Datenstream.
- **CLK** (Clock)  
Generiert die Taktrate, mit welcher die Daten übertragen werden.

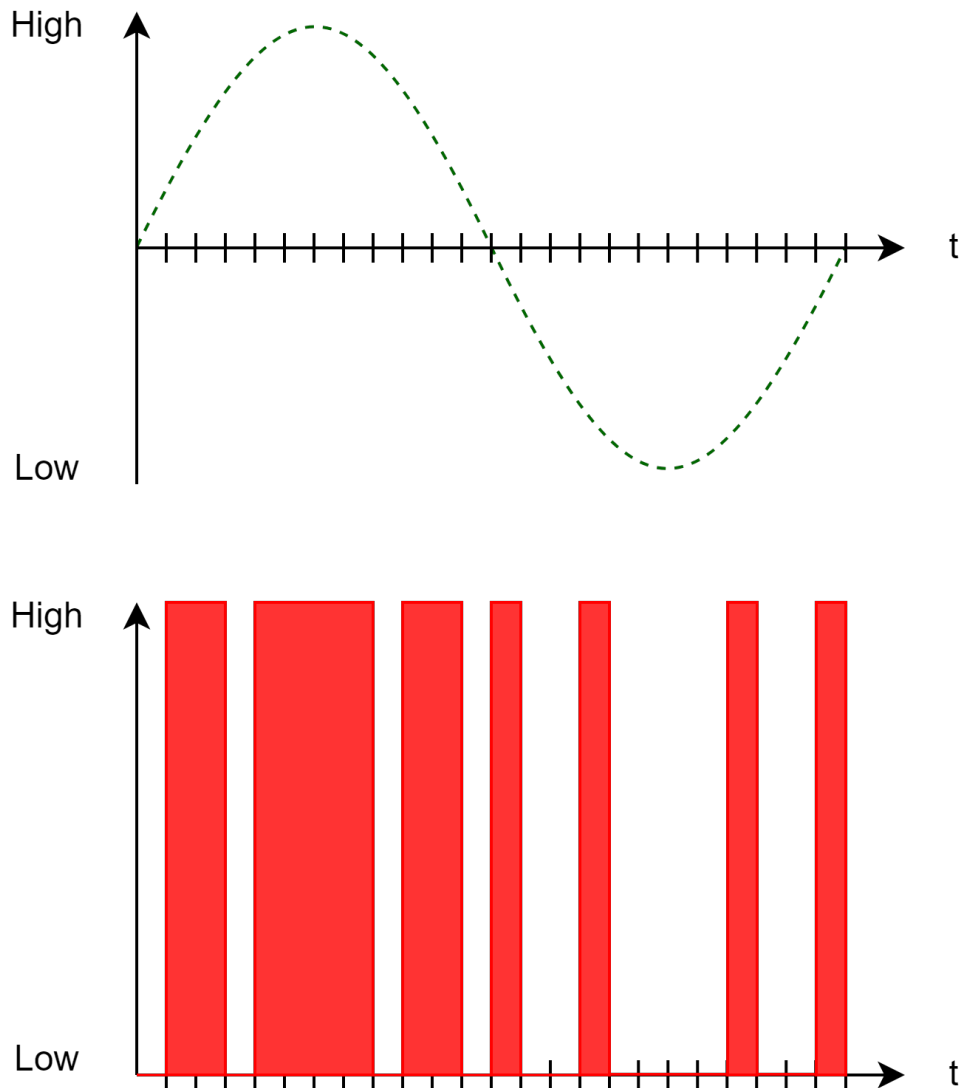


Figure 2: Beispiel PDM-Signal

#### 2.1.4 PCM

Bei **P**ulse **C**ode **M**odulation wird jeder analoge Messwert in einem digitalen Bereich abgebildet (Abbildung 3). Je nach benötigter Genauigkeit fällt dieser Bereich mal grösser, mal kleiner aus. Bei der Datenübertragung mittels I<sup>2</sup>S

(2.1.2) geschieht diese Umwandlung direkt im Sender und erzeugt somit das SD-Signal. Bei Sendern mit PDM-Ausgang (2.1.3) ist dies nicht der Fall. Hier ist im Empfänger zwingend eine Peripherie notwendig, welche das PDM-Signal mittels Unterabtastung in ein PCM-Signal umwandelt.

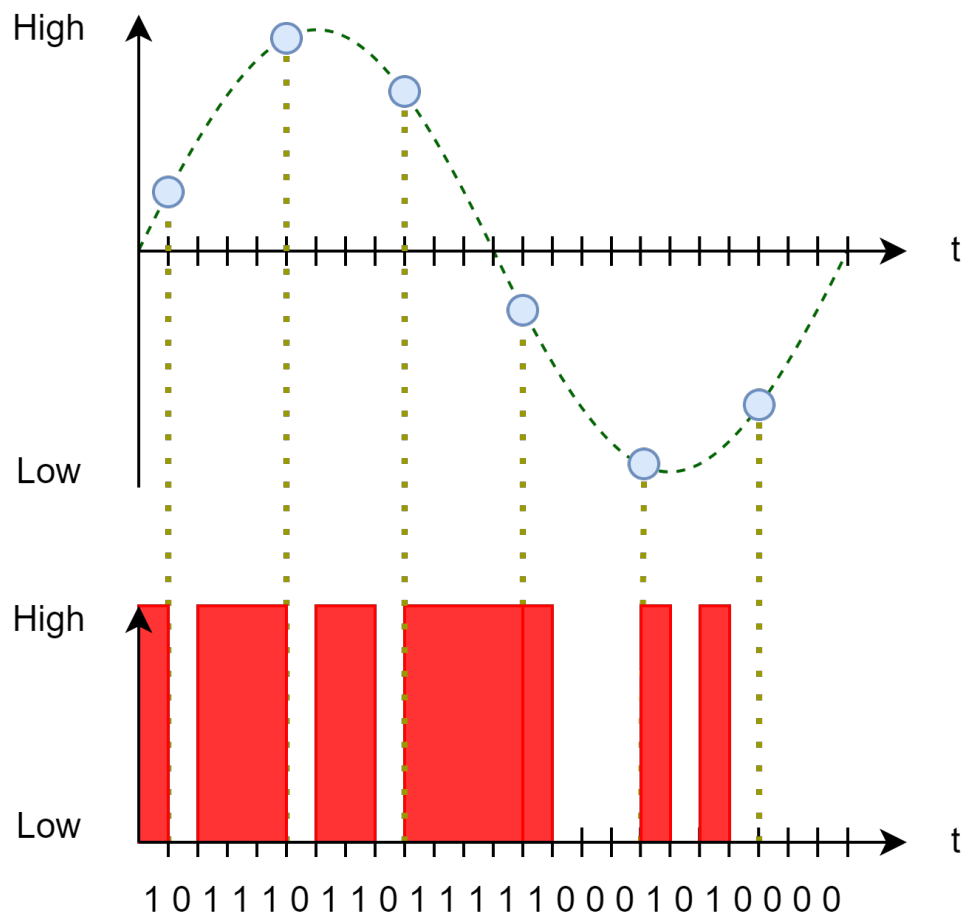


Figure 3: Beispiel PCM-Signal

### 2.1.5 Schalldruckpegel

TODO



### 2.1.6 Frequenzbewertung

Unser Gehör reagiert nicht nur nicht linear auf Lautstärkeveränderungen, sondern zusätzlich auch unterschiedlich Sensitiv auf unterschiedliche Frequenzen im hörbaren Bereich (20Hz-20kHz). Insbesondere im Bereich zwischen 3kHz bis 4kHz [1] ist das Gehör besonders anfällig auf äussere Stimulation. Abbildung 4, ursprünglich durch Fletcher & Munson, mittlerweile auch durch den ISO226-Standard beschrieben, zeigt diesen Umstand. Um der Problematik aus Abbildung 4 Sorge tragen zu können, wird ein sogenannten Frequenzbewertungsfilter <sup>1</sup>, Abbildung 5, eingesetzt. Dabei werden heutzutage nur noch die dB(A), sowie der dB(C)-Filter eingesetzt. Die beiden Filter unterscheiden sich folgendermassen:

- dB(A)
  - Reproduziert die 40 Phon Kurve
  - Widerspiegelt das menschliche Gehör besser, als der dB(C)-Filter
- dB(C)
  - Reproduziert die 100 Phon Kurve.
  - Filtiert weniger tiefe und hohe Frequenzen als dB(A) heraus
  - Wird verwendet, um besonders laute Umgebungen zu messen

---

<sup>1</sup>Weighting curves

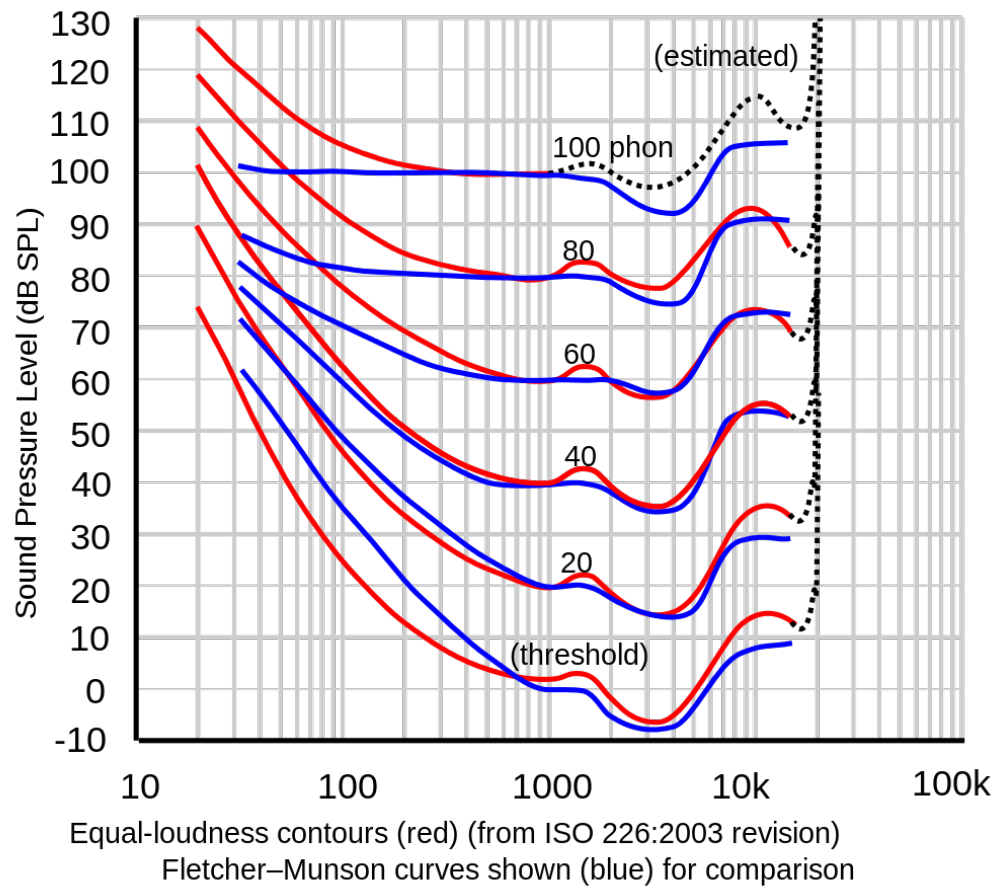


Figure 4: Phon-Kurven im Vergleich | Quelle: [1]

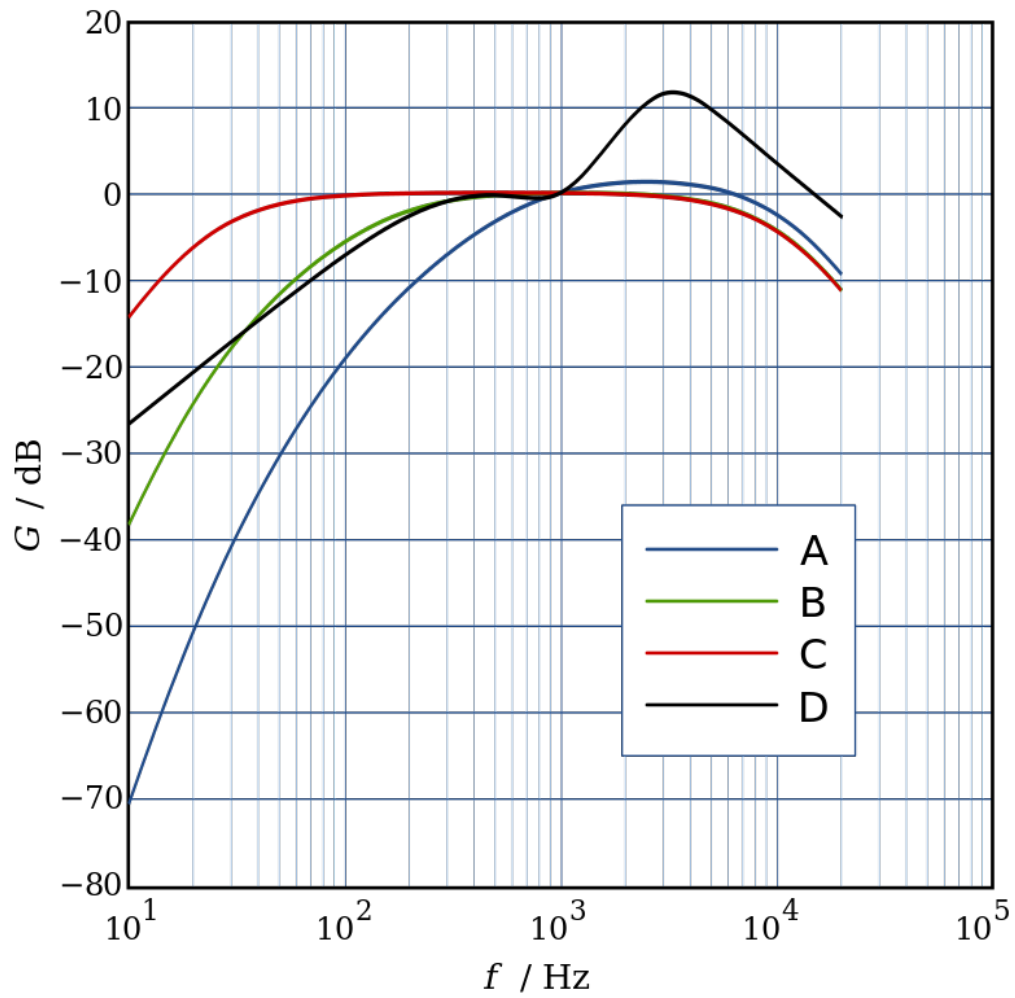


Figure 5: Frequenzbewertungsfilter | Quelle: [2]

## 2.2 Komponentenwahl

### 2.2.1 Kriterien

- Standort der Mikrofonöffnung
- Ausgangssignal
- Maximaler Schalldruckpegel

- MEMS-Technologie
- Frequenzbereich

### 2.2.2 Vergleich

Typ	Protokoll	Öffnung	SNR	AOP[dB]	$f_{min}$ [Hz]	$f_{max}$ [Hz]
ICS-43434	I2S	Unten	65	120	60	20000
ICS-41351	PDM	Oben	65	120	50	20000
MMICT5838-00-012	PDM	Unten	68	133	27	20000
CMM-4737DT-26386-TR	PDM	Oben	58	120	100	10000
CMM-4737DT-26186-TR	PDM	Oben	58	120	100	10000
MP34DT05(-A)	PDM	Oben	64	122.5	100	10000
MP34DT06J	PDM	Oben	64	122.5	100	10000
SPH0645LM4H-B	I2S	Unten	65	120	20	10000

Table 1: Vergleich Mikrofone

### 2.2.3 Fazit

$\frac{1}{3}$  der untersuchten Mikrofone weisen die Mikrofon-Öffnung auf der Unterseite auf. Dies ermöglicht es, einen höheren SNR gewährleisten zu können, jedoch ist diese Montageart für das Endprodukt nicht geeignet (siehe Kapitel 5). Bei den restlichen Mikrofonen sticht das ICS-41351 von TDK InvenSense mit seinem hohen SNR, AOP sowie der hohen Frequenzbandbreite heraus. Dadurch hat dieses das Rennen gewonnen.

## 3 Mikrocontroller

### 3.1 Grundlagen

#### 3.1.1 DMA

Bei **D**irect **M**emory **A**ccess handelt es sich um eine Art Steuerbaustein, welcher unabhängig und parallel zum eigentlichen Rechenkern arbeitet. Dieser hat, wie der Rechenkern selbst, Zugriff auf den gesamten Datenbus. Dieser ermöglicht es, effizient Daten von Peripherien wie der UART, I<sup>2</sup>S, SPI, ect. in den RAM und umgekehrt zu laden. Dadurch wird der Rechenkern entlastet und kann für wichtigere Aufgaben eingesetzt oder gar in einen Energiesparmodus versetzt werden. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten mit dem DMA-Baustein zu interagieren:

- **Bus Master**  
Der DMA-Baustein wird einmalig durch den Rechenkern aufgesetzt und läuft danach autonom. So können beispielsweise via I<sup>2</sup>S einkommende Daten automatisch aus dem Eingangsregister in den Speicher geladen werden und bei genügend grosser Datenmenge (definiert durch den Entwickler), kann Rechenkern wieder aus dem Energiesparmodus aufgeweckt werden.
- **Programmed I/O**  
Jeder Arbeitsprozess des DMA-Bausteins wird durch den Rechenkern gestartet. Da sich DMA und Rechenkern den Datenbus teilen, wird so garantiert, dass die Speicheroperation zum gewünschten Zeitpunkt stattfindet.

#### 3.1.2 Bootloader

Unter einem Bootloader versteht man Code, welcher grundsätzlich nach dem erstmaligen flashen, persistent im System bleibt. Er dient als Ausgangspunkt für die eigentliche Software und ermöglicht es beispielsweise auch, während der Laufzeit des Gerätes, Softwareupdates herunter zu laden und diese anschliessend einzuspielen. Insbesondere wenn Funkprotokolle wie Bluetooth oder WLAN eingesetzt werden, ist ein Bootloader oftmals unerlässlich. Der Nachteil ist jedoch, dass dieser den ohnehin knappen Speicherplatz weiter reduziert.

### 3.1.3 RTC

Unter einer **Real Time Clock** versteht man ein Stück Hardware (intern oder extern), welche die Zeit ab Inbetriebnahme misst. Übliche RTCs haben, aufgrund ihrer Bauweise eine Genauigkeit von 100ppm. Da dies einer Zeitverschiebung von 4min und 19s @32kHz entspricht, enthalten die meisten RTCs Kompensationsmechanismen, um diese Zeit auf unter 100ms zu bringen. [3]

### 3.1.4 Low Power

Mit Low Power wird, insbesondere bei Embedded-Systemen, die reduzierte Leistungsaufnahme beschrieben. Oftmals verfügen die Systeme über mehrere Modi mit jeweils unterschiedlichen Eigenschaften. Das Ziel ist es, mit jedem tieferen Modus etwas mehr Energie zu sparen und somit die Akkulaufzeit zu verlängern. Wie in Abbildung 6 ersichtlich, sinkt zwar die Leistungsaufnahme mit jeder Stufe, jedoch werden dabei gewisse Peripherien abgeschaltet und die allgemeine Startzeit des Systems wird erhöht.

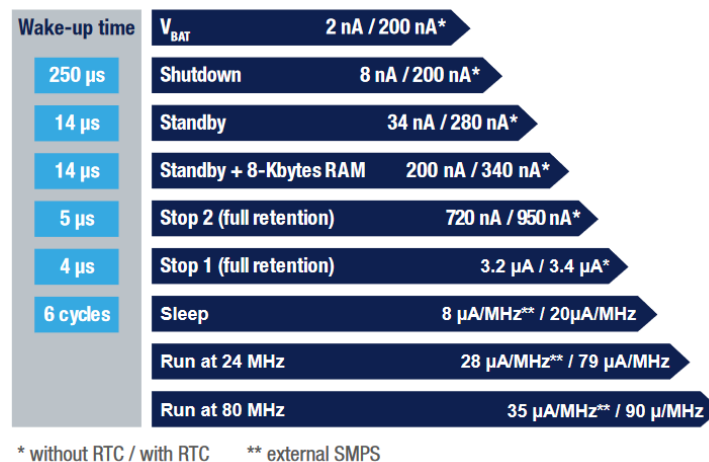


Figure 6: Vergleich Low-Power-Modi STM | Quelle: [4]

### 3.1.5 Peripherie in Hardware oder Software

Bei allen gängigen Kommunikationsprotokollen ist die Frage, wie diese implementiert werden sollen. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- in **Hardware**
  - + Die benötigte Infrastruktur (Register, CRC, etc.) sind bereits physikalisch

implementiert. Die Kommunikation kann dementsprechend vom Rechenkern abgekoppelt durchgeführt werden und ermöglicht eine gewisse Parallelität von mehreren Prozessen mit wenig Rechenaufwand. Insbesondere in Verbindung mit DMA, kann so viel Rechenzeit eingespart werden.

- Bei den meisten Mikrocontrollern ist die spezifische Hardware an einzelne Pins gebunden. Dies wirkt sich auf die Flexibilität des PCB-Layouts oder gar des Gesamtsystems (zu wenig Anschlüsse) aus.

- in **Software**

- + Die meisten Pins können flexibel für jedes Protokoll verwendet werden. Dadurch vereinfacht sich auch das PCB-Layouten.

- Bei Verwendung von Ein-Kern-Systemen, welche im Embedded-Bereich mehrheitlich anzutreffen sind, kann keine echte Parallelität von Prozessen erfolgen. Dies verringert die Ausführungsgeschwindigkeit.

Grundsätzlich ist, nach Möglichkeit und Verfügbarkeit, eine Hardware-Peripherie zu bevorzugen. Insbesondere bei batteriebetriebenen Systemen mit langer Laufzeit, ist diese ausschlaggebend.

## 3.2 Komponentenwahl

Es existieren eine Vielzahl von Mikrocontroller-Herstellern. Viele dieser verfügen über eine breite Palette an BLE-tauglichen Chips. Um den geeigneten darunter zu finden, werden nachfolgend die benötigten Schnittstellen definiert und mehrere, vorselektionierte Mikrocontroller, miteinander verglichen.

### 3.2.1 Kriterien

- **I<sup>2</sup>S** + **PDM** zur Ansteuerung des Mikrofons.
- **SPI** zur Ansteuerung von möglichen Peripherien wie externe Speicherbausteine oder Displays.
- **I<sup>2</sup>C** zur Ansteuerung von Laderegler und LED-Treiber-IC.
- **DMA** zur energieeffizienten Verarbeitung der Daten.
- **RTC** um die gemessenen Werten mit einem Zeitstempel verknüpfen zu können.

- BLE-Fähiger Mikrocontroller mit vorgefertigter Antenne um die Integration zu vereinfachen.

### 3.2.2 Vergleich

Hersteller	Typ	I2S	I2C	SPI	DMA	BLE	PDM	RTC	ANT	Flash (kB)	uA/MHz	Zusatz
Infineon	CY8C63x6	x	x	x	x	x	x	x	-	<=512	40	Nicht via normale Distributoren
Infineon	CY8C63x7	x	x	x	x	x	x	x	-	<=512	40	Nicht via normale Distributoren
Microchip	BM83	x	x	-	-	x	x	-	-	-	-	Charge-controller für Akku <b>Not recommended for new Designs</b>
Nordic Semiconductor	nRF52832	x	x	x	x	x	x	x	x	<=512	58	ANT: BMD-350-A-R (u-blox)
Nordic Semiconductor	nRF52833	x	x	x	x	x	x	x	x	512	52	ANT: NINA-B406-00B (u-blox) BL653 (Lairdconnect)
Nordic Semiconductor	nRF52840	x	x	x	x	x	x	x	x	1024	52	ANT: NINA-B302-00B (u-blox) BMD-340-A-R (u-blox) BL654PA (Lairdconnect)
Nordic Semiconductor	nRF5340	x	x	x	x	x	x	x	x	1024	48	ANT: NORA-B106-00B (u-blox) BL5340 (Lairdconnect)
Silicon Labs	EFR32BG22	x	x	x	x	x	x	x	x	<=512	27	ANT: BGM220P Lyra P (Lairdconnect)
Silicon Labs	EFR32BG27	x	x	x	x	x	x	x	-	768	29	-
STmicro	STM32WB	x	x	x	x	x	x	x	x	1024	53	ANT: STM32WB5MMG
STmicro	BlueNRG-LP	x	x	x	x	x	x	x	-	256	18	-

Figure 7: Vergleich von möglichen Mikrocontrollern

### 3.2.3 Fazit

Wie dem Vergleich zu entnehmen ist, unterscheiden sich die Mikrocontroller meist nur in der integrierten Flash-Grösse sowie der Leistungsaufnahme bei einer gewissen Taktrate. Dadurch wird die Wahl nicht eingeschränkt, was eine geeignete Evaluation nicht vereinfacht. Ausschlaggebend ist jedoch der Formfaktor. Bis auf Silicon Labs und STmicro muss für einen Mikrocontroller mit vorgefertigter Antenne auf Drittanbieter ausgewichen werden. In Zeiten von Katastrophen wie COVID oder Kriegen inmitten von Handelsrouten ist die Produktverfügbarkeit einer der zentraler Aspekte. Aus diesem Grund wird nachfolgend der EFR32BG22 von Silicon Labs bzw. dessen Modul-Variante, der **BGM220P**, eingesetzt.



## 4 LED

### 4.1 Grundlagen

#### 4.1.1 Wellenlänge

#### 4.1.2 Leistungsaufnahme

#### 4.1.3 Lichtleistung

#### 4.1.4 Vorwiderstand / Strombegrenzung

Nach Anlegen einer Spannung,  $\geq$  Schwellspannung der LED <sup>2</sup>, wird diese grundsätzlich zu einem Kurzschluss. Um den Stromfluss durch die LED begrenzen zu können, wird normalerweise ein Vorwiderstand verwendet. Der Nachteil des Vorwiderstandes ist es, dass, gegeben durch das ohmsche Gesetz, über diesem elektrische Leistung in Wärme umgewandelt wird. Bei einem akkubetriebenen Gerät ist dies unerwünscht. Als Alternative kann ein buck converter, Abbildung 8, oder eine Konstantstromquelle eingesetzt werden. Dadurch entfällt der Vorwiderstand und die Effizienz des Teilsystems wird erhöht.

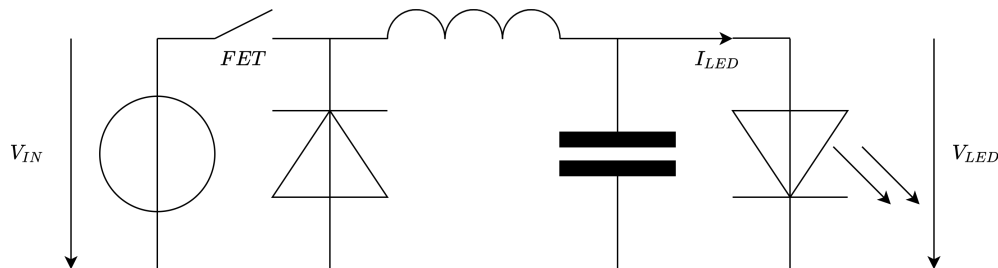


Figure 8: Buck Converter

### 4.2 Komponentenwahl

#### 4.2.1 Kriterien

- Lichtleistung
- Wellenlänge

---

<sup>2</sup>variiert je nach LED Typ und Farbe

### 4.2.2 Vergleich

Hersteller	Typ	Farbe	Intensität[mcd] <sup>3</sup>	Spannung [V]
SunLED	XZCM2CRK53WA-8VF	Rot	180	2.1
SunLED	XZCDGK53W-8VF	Grün	250	3.1
SunLED	XZCFBB53W-8VF	Blau	30	3
Worldsemi	WS2018	Rot	55	2.2
Worldsemi	WS2018	Grün	110	3.1
Worldsemi	WS2018	Blau	20	3.4
RND	135-00184	Rot	7	1.6

Table 2: Vergleich LED

### 4.2.3 Fazit

Wie im Kapitel 4.1.1 ersichtlich, ist die Abwägung zwischen Leistungsaufnahme der LED und der effektiven Photonenabgabe nicht trivial. Aus technischer Sicht macht dementsprechend eine LED mit einer Wellenlänge von 555nm (Grün) am meisten Sinn. Nach Rücksprache mit dem Industriepartner, hEar, dient das Gerät an erster Stelle als Warngerät. Warnungen werden üblich mit einer Wellenlänge von 700nm (Rot) gekennzeichnet. Dadurch wird im Endprodukt die Low-Power-LED XZCM2CRK53WA-8V von SunLED eingesetzt.

---

<sup>3</sup>bei einem Strom von 2mA

## 5 Entwicklung

### 5.1 Konzept

Die im Unterkapitel 1.2 definierten Ziele sollen nun umgesetzt werden. Dazu soll die von aussen sichtbare Vorderseite möglichst wenig Bauteile aufweisen, um das visuelle Design nicht zu beeinträchtigen. Mit einer angestrebten Gesamtgrösse von 60mm Durchmesser, können die gewählten Bauteile geradenoch auf dem PCB in einer symmetrischen Art platziert werden.

**Front** Die Vorderseite weist folgende Bauteile auf:

- 8 LEDs
- Mikrofon
- LED-Treiber-IC

Zudem sind die LEDs ringförmig angeordnet, um der Anforderung eines visuellen Ladebalkens entsprechen zu können.

**Back** Die Rückseite hingegen, beinhaltet folgende Bauteile:

- USB-C-Ladeanschluss
- Polyfuse (Automatisch rückstellbarer Überstromschutz)
- Switch um generell das Gerät ein- und auszuschalten
- BMS, um den Akku sicher auf- und entladen zu können
- Mikrocontroller, welcher sich aufgrund seiner Antenne am Rand des PCBs befinden muss
- Akkuhalter
- Optionaler Speicherbaustein

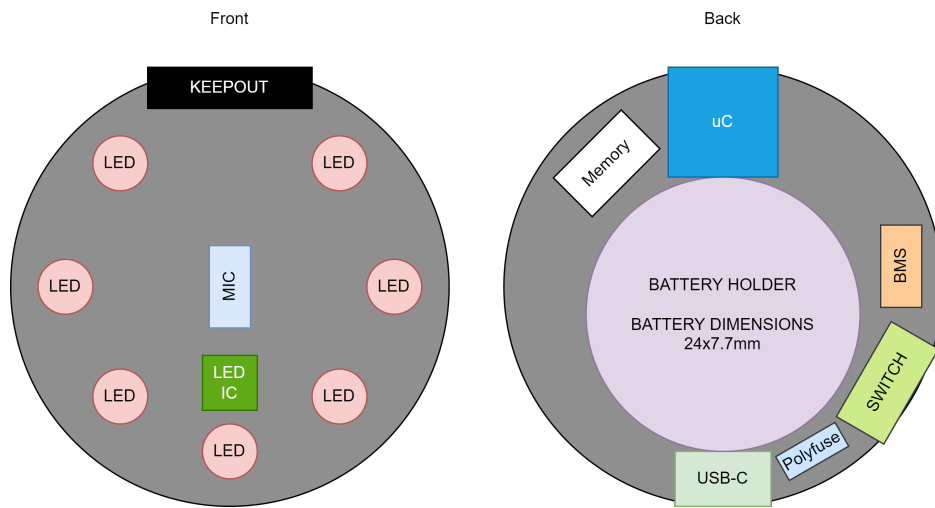


Figure 9: Konzept PCB-Layout

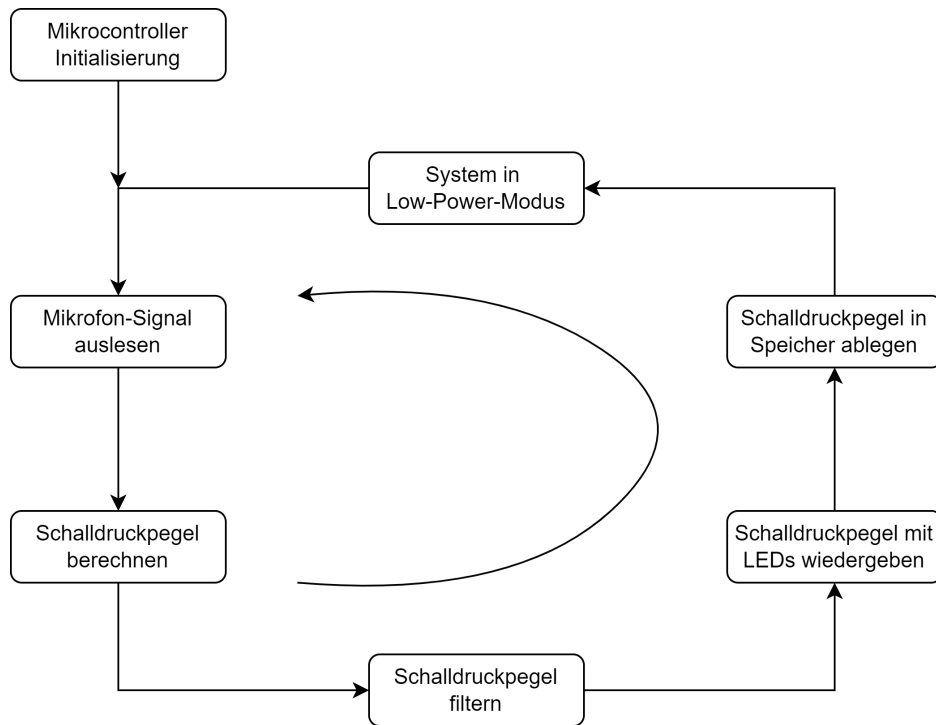


Figure 10: Konzept Softwareablauf

## 5.2 Hardware

### 5.2.1 PCB

#### Laderegler

### 5.2.2 Kosten

Die Tabelle 3 beinhaltet alle anfallenden Materialkosten exkl. Versand. Zudem wurde JLCPCB als PCB-Hersteller gewählt, da zum einen die Qualität bei 2-Layer-PCBs ausreicht und zum anderen mit der Anbindung an LCSC die Bestückung der PCBs direkt im selben Werk stattfindet. Dadurch verkürzt sich die Fertigung des Endproduktes.

Die vorhandenen Kondensatoren, sowie die benötigten Widerstände werden in der Tabelle 3 unter Diverse zusammengefasst. Dies aus dem Grund, dass keines dieser Bauteile einer besonderen Toleranz unterliegt. Dadurch kann bei der PCB-Bestellung eine kosten-optimierte Wahl getroffen werden.

Hersteller	Typ	Bezeichnung	Preis/100
JLCPCB	-	PCB inkl. Versand	0.394
Texas Instruments	BQ21040DBVR	Batterie-Management	0.516
Microchip Technology	MIC5504-3.3YM5-TR	3V3 LDO	0.095
RS PRO	LIR2477	Akku	4.085
Littlefuse	1210L020WR	Rückstellbare Sicherung	0.205
Texas Instruments	LP55231SQX/NOPB	9-Kanal LED-Treiber IC	1.35
SunLED	XZCM2CRK53WA-8VF	LED RED CLEAR 2SMD	0.2072
C&K	JS102011SAQN	Schalter 0.3A@6V	0.453
Keystone Electronics	1025-7	Batteriehalter 24x7.7mm	1.26
STMicroelectronics	M95P16-IXMNT/E	16MBit SPI EEPROM	0.843
Silicon Labs	BGM220PC22WGA2R	Mikrocontroller	6.33
TDK InvenSense	ICS-41351	MEMS-Mikrofon	1.05
GCT	640-USB4125-GF-A	USB-C Buchse 6 Pin TOP	0.381
Toshiba	SSM3J334R,LF	P-Channel MOSFET	0.109
Diverse	Capacitor & Resistor	Abmessung: 0603 [Inch]	0.6
			<b>17.90 CHF</b>

Table 3: Materialliste | Stand: 01.04.2024

## 5.3 Software

### 5.3.1 Filterdesign

Wie im Unterkapitel 2.1.6 erläutert, reagiert unser Gehör nicht auf alle Frequenzen gleich. Um diese Frequenzbewertung in die Schalldruckpegel-Berechnung einfließen zu lassen, wird ein digitales, diskretes Filter benötigt. Die benötigten Frequenzbewertungsfilter werden jedoch fast ausschliesslich in der S-Ebene (Laplace-Bereich, zeitkontinuierlich) veröffentlicht. Dadurch müssen diese mit der bilinen Transformation [5] vom Frequenz- in den Zeitbereich transformiert werden.

$$G_A(s) = \frac{7.39705 \cdot 10^9 \cdot s^4}{(s + 129.4)^2 \cdot (s + 676.7) \cdot (s + 4636) \cdot (s + 76617)^2} \quad (1)$$

$$G_C(s) = \frac{5,91797 \cdot 10^9 \cdot s^2}{(s + 129,4)^2 \cdot (s + 76617)^2} \quad (2)$$

### 5.3.2 PDM

### 5.3.3 I<sup>2</sup>C

### 5.3.4 SPI

## **6 Messungen**

### **6.1 Leistungsaufnahme**

### **6.2 Mikrofon-Kalibrierung**

### **6.3 Vergleich**

## 7 Fazit und Ausblick



## 8 Anhang

### References

- [1] N. R. C. U. C. o. D. D. f. I. w. H. Impairments, R. A. Dobie, and S. V. Hemel, “Basics of Sound, the Ear, and Hearing,” in *Hearing Loss: Determining Eligibility for Social Security Benefits*, National Academies Press (US), 2004.
- [2] “Frequenzbewertung,” Oct. 2023. Page Version ID: 238201232.
- [3] G. Dighe, “TPS65950 Real-Time Clock Timing Compensation,” Oct. 2008.
- [4] “STM32L4 Series - PDF Documentation,” Mar. 2024.
- [5] A. V. Oppenheim, *Zeitdiskrete Signalverarbeitung*. R. Oldenbourg.

### Abbildungsverzeichnis

2	Beispiel PDM-Signal . . . . .	6
3	Beispiel PCM-Signal . . . . .	7
4	Phon-Kurven im Vergleich   Quelle: [1] . . . . .	9
5	Frequenzbewertungsfilter   Quelle: [2] . . . . .	10
6	Vergleich Low-Power-Modi STM   Quelle: [4] . . . . .	13
7	Vergleich von möglichen Mikrocontrollern . . . . .	15
8	Buck Converter . . . . .	16
9	Konzept PCB-Layout . . . . .	19
10	Konzept Softwareablauf . . . . .	19

#### 8.1 Fremdwörter

CRC  
Register  
Pins  
Embedded  
ppm  
flashen